ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Установка шлифовки и полировка пластин EVG-250

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установка шлифовки и полировки пластин EVG-250 обеспечивают обработку полупроводниковых пластин и подложек диаметром до 250 мм на основе таких материалов как кремний (Si), германий (Ge), карбид кремния (SiC), арсенид галлия (GaAs), нитрид галлия (GaN), нитрид алюминия (AlN), фосфид индия (InP), сапфир, керамика, стекло, титан, сталь. Загрузка подложек осуществляется оператором вручную, а процесс утонения автоматически согласно заданному рецепту. Помимо поштучной обработки, доступна возможность групповой обработки подложек, закреплённых на временном носителе диаметром до 250 мм. Установка EVG-250 оснащается специальными шлифовальными/полировальными дисками Engis на основе технологии MAD

(Mixed Abrasive Diamond), которая адаптирует спецификацию диска к типу обрабатываемого материала для достижения оптимальной плоскостности, шероховатости и исключает необходимость использования дополнительного оборудования. Компактные габаритные размеры в сочетании с широкими функциональными возможностями установки шлифовки и полировки EVG-250 соответствуют современным требованиям мелкосерийного производства или научно-исследовательских лабораторий.

Возможны бесплатные тесты шлифовки и полировки в лаборатории производителя на образцах заказчика.

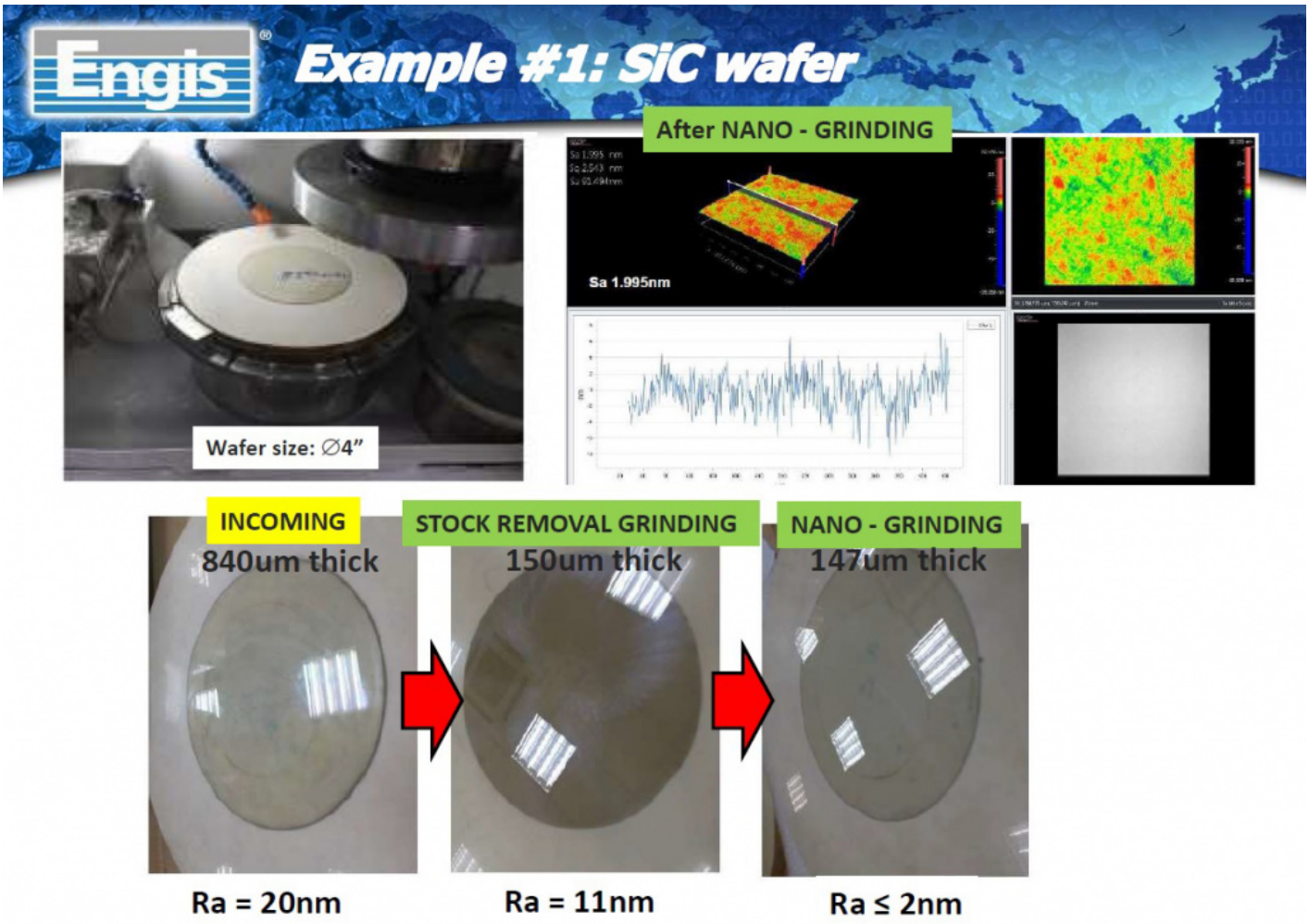

Рис.1. Пример утонения пластины SiC Ø100 мм с 840 мкм до 147 мкм с использованием шлифовальных/полировальных дисков Engis.

Технические характеристики

Загрузка	Ручная
Тип обработки	Одиночная или групповая

Материал подложек	Si, Ge, SiC, GaAs, GaN, AlN, InP, сапфир, керамика, стекло, металлы
Размер образца	Пластины диаметром до 250 мм, групповые заготовки Прямоугольные подложки до 176×176 мм
Толщина образца	До 50 мм
Размер рабочего стола	Ø250 мм *(опционально Ø300мм)*
Размер шлифовального диска	Ø255мм *(опционально Ø305мм)*
Мощность привода	5 кВт
Возможность проводить процессы шлифовки и полировки при помощи сменных дисков	Наличие
Скорость вращения рабочего стола	Макс. 400 об/мин (CW и CCW вращение)
Мощность привода стола	1.5 кВт
Скорость вращения шлифовального диска	Макс. 2000 об/мин (CW и CCW вращение)
Мин. скорость подачи	6 мкм/мин (0.6 мкм/с) Опционально 0.6 мкм/мин (0.01 мкм/с)
Макс. скорость подачи	600 мкм/мин (10 мкм/с)
Управление	Промышленный ПЛК (Mitsubishi / Keyence) Цветной сенсорный дисплей 7.4" Независимой контроль скорости вращения стола и диска Светозвуковая колонна типа «светофор» 3 уровня доступа (оператор, наладчик, технолог)
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	900×900×1900 мм
Вес	1100 кг

Питание	380 В, 50 Гц, 3ф.
Сжатый воздух	0.5 – 0.8 МПа
Дополнительные опции	Встроенная станция заточки рабочего диска Встроенная система контроля толщины пластин